

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 981)

須予披露交易

根據批量採購協議及購買單作出購買

本公司公布，本公司根據批量採購協議已於 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 2 日的 12 個月期間就購買阿斯麥產品與阿斯麥集團簽訂購買單。

由於有關阿斯麥購買單於香港上市規則第 14 章規定的一個或多個適用的百分比率高於 5% 但低於 25%，阿斯麥購買單構成本公司的須予披露交易，須遵守香港上市規則第 14 章的公告規定。

緒言

於 2021 年 2 月 1 日，本公司與阿斯麥上海簽訂了經修訂和重述的阿斯麥批量採購協議，據此，阿斯麥批量採購協議的期限從原來的 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日延長至從 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

本公司根據批量採購協議已於 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 2 日的 12 個月期間就購買用於生產晶圓的阿斯麥產品與阿斯麥集團簽訂購買單。

批量採購協議作為阿斯麥購買單所載條款及條件的參考，且批量採購協議下的購買是通過本公司簽訂購買單來實現的。

經修訂和重述的阿斯麥批量採購協議及阿斯麥購買單

經修訂和重述的阿斯麥批量採購協議

日期及訂約方

日期：2021 年 2 月 1 日

訂約方：

(1) 本公司；及

(2) 阿斯麥上海

本公司確認，經作出所有合理查詢後所深知、所悉及所信，阿斯麥上海及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

協議年期

本協議的有效期直至 2021 年 12 月 31 日止。

經修訂和重述的阿斯麥批量採購協議的主要條款

付款

阿斯麥產品及其他設備的定價是在每次根據經修訂和重述的阿斯麥批量採購協議發出購買單時另行釐定。

每項阿斯麥產品的付款條款為：

(1) 於發出相關購買單後約百分之三十(30%)的首期付款；及

(2) 餘下款額將於交付相關阿斯麥產品時支付。

付運

根據阿斯麥購買單作出的購買的付運條款應為 FCA（貨交承運人）承包商的處所或指定目的地交貨(DAP)。

阿斯麥購買單

阿斯麥購買單乃於 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 2 日之間就阿斯麥集團向本公司供應用於生產晶圓的機器而作出。

根據阿斯麥購買單購買的阿斯麥產品定價乃按公平基準釐定。阿斯麥購買單的總代價為 1,201,598,880 美元。

有關訂約方的資料

本公司及其附屬公司共同構成世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地技術最先進全面、配套最完善、規模最大、跨國經營的集成電路製造企業，提供 0.35 微米到 14 納米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。本集團總部位於中國上海，擁有全球化的製造和服務基地。在上海建有一座 300mm 晶圓廠、一座 200mm 晶圓廠和一座實際控股的 300mm 先進製程晶圓合資廠；在北京建有一座 300mm 晶圓廠和一座控股的 300mm 晶圓廠；在天津和深圳各建有一座 200mm 晶圓廠；在江陰有一座控股的 300mm 凸塊加工合資廠。本集團還在美國、歐洲、日本和中國台灣地區設立行銷辦事處、提供客戶服務，同時在中國香港設立了代表處。

ASML Holding N.V. 是在荷蘭註冊成立的公司，並在阿姆斯特丹泛歐交易所和納斯達克上市。ASML Holding N.V. 為半導體業的全球領先供應商之一，向全球芯片製造商提供硬件、軟件及服務。阿斯麥香港和阿斯麥上海是 ASML Holding N.V. 的附屬公司。

訂立批量採購協議的理由及益處

本公司為中國最先進及最大的集成電路製造商。為應對客戶的需要，本公司繼續擴大其產能、把握市場商機及增長。

批量採購協議及阿斯麥購買單乃於本公司正常業務過程中就購置用於生產晶圓（為本公司主要業務）的相關機器作出。由於阿斯麥批量採購協議的期限已到期，本公司簽訂經修訂和重述的阿斯麥批量採購協議。

董事認為，批量採購協議及阿斯麥購買單各自的條款公平合理，符合本公司及其股東整體的利益。

香港上市規則的涵義

阿斯麥購買單為於 12 個月期間作出的一系列阿斯麥產品採購，而根據香港上市規則第 14.22 及 14.23 條，被合併計算及視作有關購買的單一交易。

由於有關阿斯麥購買單於香港上市規則第 14 章規定的一個或多個適用的百分比率高於 5% 但低於 25%，阿斯麥購買單構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章的公告規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「經修訂和重述的阿斯麥批量採購協議」 指 本公司與阿斯麥上海訂立日期為 2021 年 2 月 1 日的經修訂和重述的阿斯麥批量採購協議；

「阿斯麥集團」	指	阿斯麥香港和阿斯麥上海的統稱；
「阿斯麥香港」	指	阿斯麥香港有限公司；
「阿斯麥產品」	指	由掃描器組成的資本設備；
「阿斯麥購買單」	指	於 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 2 日根據批量採購協議就阿斯麥產品發出的購買單；
「阿斯麥上海」	指	阿斯麥（上海）機電設備有限公司；
「阿斯麥批量採購協議」	指	本公司與阿斯麥香港訂立日期為 2018 年 1 月 1 日的阿斯麥批量採購協議；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	Semiconductor Manufacturing International Corporation （中芯國際集成電路製造有限公司*）；
「董事」	指	本公司董事；
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；及
「批量採購協議」	指	阿斯麥批量採購協議和經修訂和重述的阿斯麥批量採購協議的統稱。

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司

高永崗博士

執行董事、首席財務官兼公司秘書

中國上海， 2021 年 3 月 3 日

於本公告日期， 本公司董事分別為：

執行董事

周子學 (董事長)

蔣尚義 (副董事長)

趙海軍 (聯合首席執行官)

梁孟松 (聯合首席執行官)

高永崗 (首席財務官兼公司秘書)

非執行董事

陳山枝

周杰

任凱

路軍

童國華

獨立非執行董事

William Tudor Brown

劉遵義

范仁達

楊光磊

劉明

* 僅供識別